(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2005 年11 月3 日 (03.11.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/104221 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/68, 21/301, 21/52

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/007122

(22) 国際出願日: 2005 年4 月13 日 (13.04.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-122622 2004 年4 月19 日 (19.04.2004) JP
特願2004-122623 2004 年4 月19 日 (19.04.2004) JP
特願2004-122624 2004 年4 月19 日 (19.04.2004) JP
特願2004-122625 2004 年4 月19 日 (19.04.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野中英明 (NONAKA, Hideaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小林賢治 (KOBAYASHI, Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 山本隆弘 (YAMAMOTO, Takahiro) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

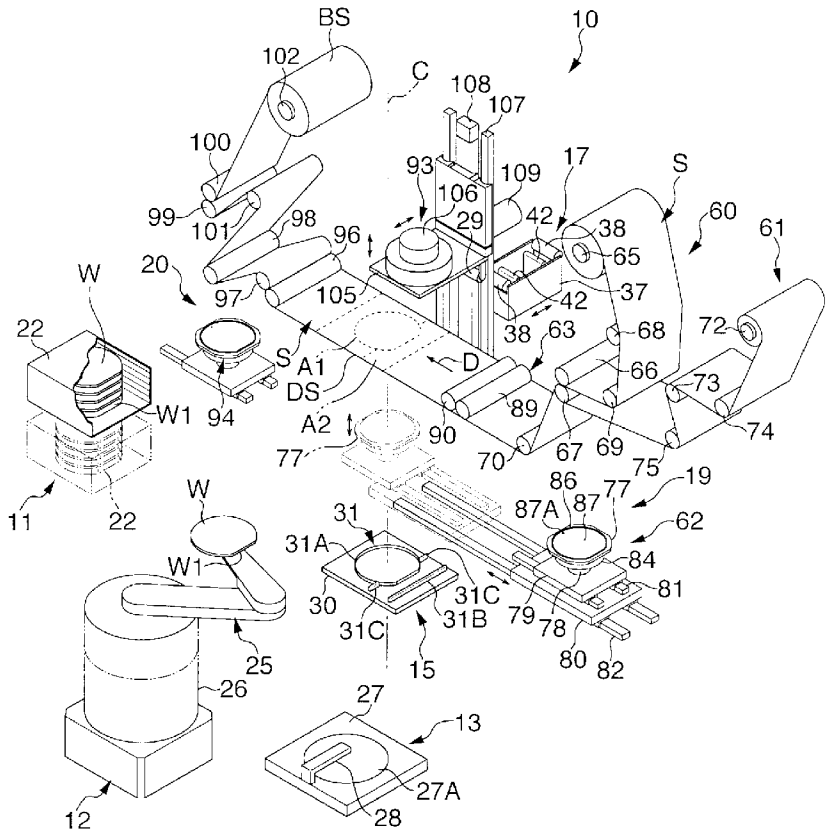
(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: APPARATUS AND METHOD FOR STICKING SHEET

(54) 発明の名称: シート貼付装置及び貼付方法



(57) Abstract: An apparatus and a method for sticking a sheet. The apparatus (10) cuts a sheet base material (S) formed by stacking a die bonding sheet (DS) on one face of a base sheet (BS) in the plane surface shape of a semi-conductor wafer to form a sticking area (A1) and sticks the sticking area on the semi-conductor wafer. The apparatus comprises a cutting means (15) forming the sticking area (A1) and a peeled area (A2), a first peeling means (17) peeling off the peeled area (A2), a sticking table (62) sticking the sticking area (A1) on the wafer, and a second peeling means (20) peeling off the base sheet from the sticking area (A1). The cutting means (15) further comprises first to third cutting blades (31A), (31B), and (31C), and forms the sticking area (A1) by the first cutting blade (31A). Also, the cutting means forms the peeled area (A2) by a part of the first cutting blade (31A) and the second and third cutting blades (31B) and (31C), and sticks the sticking area (A1) on the wafer after the peeled area (A2) is peeled off.

[続葉有]

WO 2005/104221 A1

ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: ベースシートＢＳの一方の面にダイボンディングシートＤＳが積層されたシート基材Ｓを半導体ウエハの平面形状にカットして貼付領域Ａ１を形成し、当該貼付領域を半導体ウエハ貼付するシート貼付装置１０であり、当該装置は、貼付領域Ａ１と剥離領域Ａ２を形成する切断手段１５と、剥離領域Ａ２を剥離する第１の剥離手段１７と、ウエハに貼付領域Ａ１を貼付する貼付テーブル６２と、ベースシートを貼付領域Ａ１から剥離する第２の剥離手段２０とを備える。切断手段１５は第１ないし第３の切断刃３１Ａ、３１Ｂ、３１Ｃを含んで構成され、第１の切断刃３１Ａにより貼付領域Ａ１を形成する一方、第１の切断刃３１Ａの一部と前記第２及び第３の切断刃３１Ｂ、３１Ｃで剥離領域Ａ２を形成し、この剥離領域Ａ２を剥離した後に、貼付領域Ａ１をウエハに貼付する。